

华林证券股份有限公司
关于福达合金材料股份有限公司
使用募集资金偿还银行借款的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为福达合金材料股份有限公司（以下简称“福达合金”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）对福达合金拟使用募集资金偿还银行借款的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可〔2018〕740号文核准，福达合金材料股份有限公司向社会公开发行不超过2,458万股人民币普通股，发行价格为9.65元/股。本次发行募集资金总额为237,197,000.00元，扣除发行费用（不含税）28,309,056.60元后，募集资金净额为208,887,943.40元。

上述款项已全部到账，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“中天运[2018]验字第[90034]号《验资报告》”。公司已将募集资金存放于募集资金专户管理。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司第五届董事会第九次会议和2016年第二次临时股东大会审议批准，本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	使用募集资金额	投资总额
1	年新增 370 吨电接触材料及 700 吨集成化组件项目	14,075.10	19,004.53

2	企业技术中心建设项目	3,110.60	4,200.00
3	偿还银行借款项目	3,703.09	5,000.00
合计		20,888.79	28,204.53

若募集资金不足时，由公司根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分通过自筹方式解决。如果本次募集资金到位前，公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后，将以募集资金置换出上述自筹资金。

三、使用募集资金偿还银行贷款情况

1、公司拟利用募资金 3703.09 万元用于偿还银行借款，具体偿还方案如下：

单位：万元

贷款银行	借款金额	借款期限	借款年利率	偿还金额
浙商银行龙湾支行	3,700	2017.7.25-2018.7.24	5.937%	2,703.09
兴业银行温州分行	3,780	2017.7.20-2018.7.20	5.220%	1,000

2、必要性：上述银行借款每月产生的财务费用约为 18.5 万元，为了提高资金使用效率、减少财务费用支出、降低公司资产负债率，公司提请董事会审议并同意以募资金 3703.09 万元对上述借款提前偿还。

四、相关审议程序

1、董事会意见

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募资金偿还银行借款的议案》，同意使用募集资金人民币 3703.09 万元偿还银行借款。

2、监事会意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分募资金偿还银行借款的议案》，同意使用募集资金人民币 3703.09 万元偿还银行借款。

3、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司使用部分募集资金偿

还银行借款方案的实施符合公司发展的需要,有利于提高募集资金的使用效率并增强公司在主营业务方面的竞争力,从而提高公司的经营效益,符合股东利益最大化的要求。内容和程序符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,符合公司首次公开发行股票《招股说明书》中关于募集资金使用的表述。募集资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。为此,同意公司使用部分募集资金偿还银行借款。

五、保荐机构核查意见

经核查,华林证券认为:

本次使用部分募集资金偿还银行借款事项已经公司董事会会议审议通过;独立董事、监事会均发表了同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。本次使用部分募集资金偿还银行借款的计划符合公司首次公开发行股票募集资金项目的投向,不影响其他募投项目的正常进行,不存在损害投资者利益的情况。

综上,保荐机构对本次使用部分募集资金偿还银行借款的事项无异议。

(此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于福达合金材料股份有限公司使用募集资金偿还银行借款的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 万同
万同

张浩淼
张浩淼

保荐机构： 华林证券股份有限公司

2018年5月29日